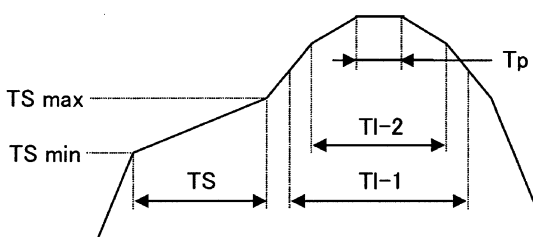


製 品 仕 様 書		No.	IS-13061-001	来歴／REV.	0
PRODUCT SPECIFICATION		頁	1／2		
標 題 : 13061 シリーズ 3.4 mmピッチ ピンヘッダー SUBJECT : 13061 SERIES 3.4 mm PITCH PIN HEADER		制定年月日 ISSUE DATE		'17-02-21	
		改訂年月日 REVISED DATA			
1. 適用範囲 本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 13061 シリーズ 3.4 mmピッチ ピンヘッダーに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。		1.Scope This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO., LTD. series 13061 3.4 mm pitch pin header.			
2. 形状、寸法及び材質 構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき品に適用する。) 適用品番：IMSA-13061B-＊＊A-TM		2.Configurations dimensions and materials See the product drawing attached. (Applied to Pb free plate product) Applied product No.: IMSA-13061B-＊＊A-TM			
3. 定格 (1)最大定格電圧： 250V (AC,DC) (2)最大定格電流： 3A (3)使用温度範囲： －40～＋105℃		3.Rating (1)Maximum rating voltage： 250 V (AC,DC) (2)Maximum rating current： 3A (3)Temperature range : －40～＋105℃			
4. 性能 特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。 常温 : 15～35℃ 常湿 : 25～85％RH		4.Environmental condition All performance test, unless otherwise specified, is taken as per following environmental condition. Ambient temperature : 15～35℃ Ambient humidity : 25～85％RH			
5. 特性		5.Performance			
5－1. 電気的性能		5-1.Electrical performance			
	項目／ITEM	条 件／Test condition		規 格／Specification	
1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	端子相互間に AC500V を 1 分間印加する。 AC 500 V shall be applied for one minute to between next terminals .		異常なきこと No changes.	
2	絶縁抵抗 Insulation resistance	端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.		初 期 値：1000MΩ以上 耐湿試験後： 100MΩ以上 Initial : 1000MΩMIN. After humidity test：100MΩMIN.	
3	外観 Appearance	目視 Visual.		有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.	
5－2. 機械的特性		5-2.Functional performance			
	項目／ITEM	条 件／Test condition		規 格／Specification	
1	ピンの保持力 Pin retention force	ピンに 25mm／分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.		9.8N 以上 9.8N MIN.	
5－3. 環境特性		5-3.Environmental performance			
	項目／ITEM	条 件／Test condition		規 格／Specification	
1	耐熱性 Heat resistance	温度 105±2℃の恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours.		5－1 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.	
2	耐湿性 Humidity	温度 60±2℃相対湿度 90～95％の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 60±2℃、90～95％RH for 96 hours.		5－1 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.	
5－4. その他特性		5-4.Other performance			
	項目／ITEM	条 件／Test condition		規 格／Specification	
1	はんだ付け性 Solderability	コネクタのはんだ付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃、3±0.5s.		浸した面積の 95％以上に半田がむらなく付着すること。 Solder shall be covered 95％ or more of the area that is dipped into the solder bath.	

項目／ITEM	条 件／Test condition	規 格／Specification														
2 はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	(1) リフローの場合 / In case of reflow ・回数/Number of reflow : 2 ・下記温度測定位置はコネクタ上面とする The temperature shall be measured on the top surface of connector.  <table><tr><th>プロファイル条件 Profile Feature</th><th>鉛フリー リフロー温度条件 Sn-Pb Eutectic Assembly</th></tr><tr><td>温度上昇 Ramp up Rate (TS max to Tp)</td><td>: 5℃ max / sec.</td></tr><tr><td>・ Pre-heat TS min. TS max. Time (TS min. to TS max.)</td><td>: 150℃ min : 200℃ max : 60-180 sec</td></tr><tr><td>T l -1 温度 / Temperature 時間 / Time</td><td>: 217 ℃ min : 60-150 sec</td></tr><tr><td>T l -2 温度 / Temperature 時間 / Time</td><td>: 255 ℃ : 40sec max.</td></tr><tr><td>Tp (ピーク / Peak) 温度 / Temperature 時間 / Time</td><td>: 260℃. : 3 sec min.</td></tr><tr><td>温度降下 Ramp down Rate (Tp to END)</td><td>: 10℃ max / sec.</td></tr></table> (2) 手はんだの場合/In case of manual soldering ・温度 / Temperature : 350±5℃ ・時間 / Time : 5±0.5 sec ・基板厚 / PCB thickness : t=1.6	プロファイル条件 Profile Feature	鉛フリー リフロー温度条件 Sn-Pb Eutectic Assembly	温度上昇 Ramp up Rate (TS max to Tp)	: 5℃ max / sec.	・ Pre-heat TS min. TS max. Time (TS min. to TS max.)	: 150℃ min : 200℃ max : 60-180 sec	T l -1 温度 / Temperature 時間 / Time	: 217 ℃ min : 60-150 sec	T l -2 温度 / Temperature 時間 / Time	: 255 ℃ : 40sec max.	Tp (ピーク / Peak) 温度 / Temperature 時間 / Time	: 260℃. : 3 sec min.	温度降下 Ramp down Rate (Tp to END)	: 10℃ max / sec.	端子のガタ、割れ等異常のない事。 Should not have any flaw , and scratch.
プロファイル条件 Profile Feature	鉛フリー リフロー温度条件 Sn-Pb Eutectic Assembly															
温度上昇 Ramp up Rate (TS max to Tp)	: 5℃ max / sec.															
・ Pre-heat TS min. TS max. Time (TS min. to TS max.)	: 150℃ min : 200℃ max : 60-180 sec															
T l -1 温度 / Temperature 時間 / Time	: 217 ℃ min : 60-150 sec															
T l -2 温度 / Temperature 時間 / Time	: 255 ℃ : 40sec max.															
Tp (ピーク / Peak) 温度 / Temperature 時間 / Time	: 260℃. : 3 sec min.															
温度降下 Ramp down Rate (Tp to END)	: 10℃ max / sec.															

6. 保存保管条件/Storage condition

室内で－10～＋40℃の温度、75％RH 以下の相対湿度の保管条件にて製造日より 1 年間とします。
Shall be storage in the house at -10～＋40℃,75%RH or less.1year from product day.

7. 圧入痕について / For press-in scar

本製品はテール実装面に圧入の痕が付くことがあります。
This product has press-in scar on the tail of mounting surface.

8. ウィスカーについて / For whisker

本製品は、ウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。
This product has effect to suppress the occurrence of whisker than normal.
However, it is not a product that guarantees that there is no occurrence of whisker.

9. 和文と英文の差異について/ Difference between Japanese and English

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。
When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, Priority shall be given to Japanese.